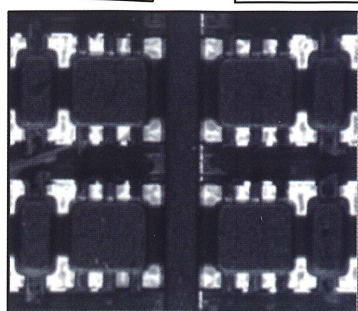
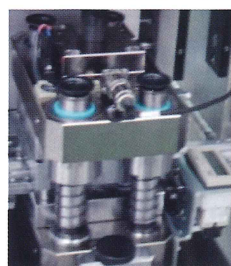
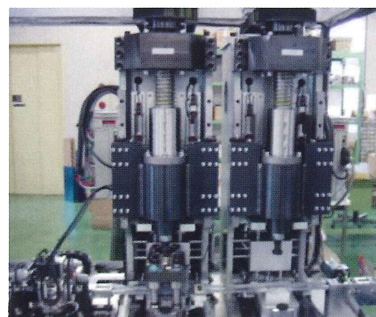
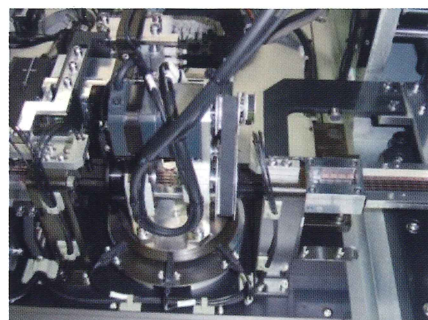
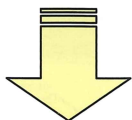
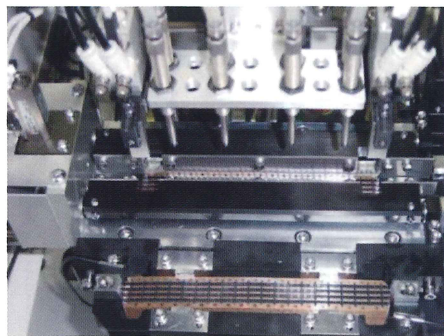


# ・営業品目 概要

企画段階よりお客様のニーズに応じた装置を設計・製作致します。



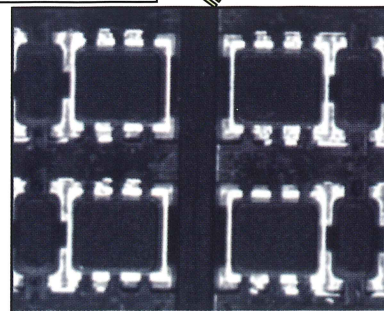
バリ取り前



## モールドレーザバリ取り装置

### 機能説明

- ・ローダ（製品供給）  
フレーム収納ラックに収納されている短冊フレームをハンドにてピックアップしシュートに搬送します。
- ・表裏判別  
表裏方向判別を行い、一定の向きに置き換えます。
- ・ゲートカット  
サーボプレス機構を採用し、製品にダメージを与えずゲートを切断します。
- ・レーザバリ取り  
レーザを使い、半導体の外周に存在する余分なモールドを除去します。
- ・アンローダ（製品収納）  
フレームをフレーム収納ラックに収納します。



バリ取り後

